

## IC CHINA 2024将于11月18—20日在北京国家会议中心举办

本报讯 第二十一届中国国际半导体博览会(IC CHINA 2024)正式定档,将于11月18—20日在北京国家会议中心举办。据悉,本届博览会将设置八大特色展区,链接全产业链生态,还将举办包括“开幕式及主论坛”“2024全球IC企业家大会”等十余场专题论坛,以及产业对接会、新品发布会、行业赛事和人才招聘会等同期活动。

以“集合全行业资源·成就大产业对接”为主题,IC CHINA 2024聚焦半导体产业链、供应链及超大规模应用市场,全景展现半导体产业的发展趋势和技术创新,汇聚全球行业资源,促进全行业交流合作,打造全球IC行业的顶级权威盛会。

本届博览会由中国半导体行业协会主办,北京赛迪出版传媒有限公司(以下简称“赛迪传媒”)承办,并得到国内外近50家半导体相关协会及组织机构协办支持。本届展会在展览规模、展区规划上再升级,展览面积达到4万多平方米,设置八大特色展区,链接全产业链生态。其中,产业链展区全面展示半导体产业链上下游创新产品、前沿技术

和企业综合实力形象,内设半导体材料和电子元器件、设计、设备、制造、封装等五个分区;地方展团重点展示全国各地特色产业、发展成果及科技创新;化合物半导体展区重点展

示碳化硅、磷化铟、碳化硅等化合物半导体及在航空航天、石油勘探等领域的创新应用;新兴应用专区展示半导体在汽车、储能、智能终端等领域的应用创新;半导体第三方服务展区主要展示厂区建设、运输、测试、洁净、泵阀、产业投资、法律援助等半导体配套服务产业的风采;产教融合展区展示全国有关院校强化集成电路产业创新人才培养机制、加强人才建设搭建的人才对接平台;国际洽谈展区聚焦国际知名企业、展示全球前瞻技术设备,促进全球技术交流与合作;未来产业展区主要展示“机器人+”“人工智能+”典型应用场景,以及未来制造、未来能源、未来空间等重点领域。

本届博览会紧扣时代发展脉搏,聚焦产业热点话题,将举办多场研讨活动,分享前沿技术、创新应用和商业模式,探讨产业可持续发展机遇,致力打造为全球集成电路行业交流经验、凝聚共识,展现产业最新理念、先进技术经验与前瞻观点的舞台。

为期3天的大会,将举办包括“开幕式及主旨论坛”“2024全球IC企业家大会”等十余场专题论坛,邀请院士专家、半导体企业负责人、行业协会知名人士、投资机构合伙人等嘉宾出席,针对人工智能、汽车芯片、半导体制造、新材料等领域开展高峰对话,共谋半导体发展新的格局。(艾西)

## 安森美将成为大众集团电动汽车平台主驱逆变器主要供应商

本报讯 安森美近日宣布,其成为大众集团 SSP (Scalable Systems Platform) 可扩展系统平台(电动汽车平台主驱逆变器(Traction Inverter)的主要供应商。安森美将为该平台提供基于SiC碳化硅技术的完整电源箱解决方案。

SSP是大众汽车面向其下一代汽车的统一电动平台,预计于2026年推出。安森美的电源箱解决方案将搭载其近日推出的新一代EliteSiC M3e MOSFET上。该平台晶体管芯片能显著降低能耗,且能够在更小的封装内处理更大功率。安森美宣称其EliteSiC M3e MOSFET较前几代产品导通损耗减少30%、关断损耗降低多达50%,并具有超低导通电阻和抗短路能力;基于该材料的设计在同等输出功率下用料可减少20%。

而在整体电源箱解决方案

中,三个集成的半桥模块安装在冷却通道上,确保了热量从半导体器件到冷却液外壳的高效传导,进一步提高了系统的效率,提升了电动汽车的续航里程。

大众汽车品牌采购董事会成员兼集团采购扩展执行委员会成员Dirk Grobe-Loheide表示:“我们非常高兴安森美能成为SSP平台首批主驱逆变器电源箱的战略供应商。从原材料到电源箱组装,安森美的深度垂直化供应链让我们信服。”

大众汽车集团动力总成采购高级副总裁Till von Bothmer补充称:“除了垂直整合之外,安森美还依托其亚洲、欧洲和美国等地区布局SiC晶圆厂,进一步提出了弹性供应概念。此外,安森美将不断提供最新一代的碳化硅技术,以确保我们在市场上的竞争力。”(安文)

## 恩智浦第二季度汽车芯片营收下滑7%

本报讯 7月22日,车用芯片大厂恩智浦半导体(NXP)公布了2024会计年度第二财季(截至2024年6月30日)财报。数据显示,第二财季公司营收年减5%,至31.3亿美元,符合预期。经调整每股盈余为3.20美元,略低于分析师预估的3.21美元。NXP表示,所有重点终端市场的表现都符合预期。

从业务上看,恩智浦车用芯片营收17.28亿美元,年减7%,季减4%;工业与物联网芯片营收6.16亿美元,年增7%,季增7%;移动芯片营收3.45亿美元,年增21%,季减1%;通信基础设施与其他产品营收为4.38亿美元,年减

23%,季增10%。LSEG数据显示,恩智浦第二财季车用芯片营收的减幅为近三年来最大,主要因为主力客户的汽车产业因需求疲软而延后下单,以待降息后景气好转。

展望第三财季,恩智浦预估第三财季营收将介于31.5亿美元至33.5亿美元,低于分析师的平均预估的33.6亿美元之间;预计调整后毛利润率为58%~59%,分析师预期为58.5%。调整后运营利润预计为10.8亿~12.1亿美元,分析师预期为11.7亿美元;经调整每股盈余预计介于3.21美元至3.63美元之间,其中间值也低于分析师平均预期的3.61美元。(智讯)

## 《中国电子报》拟领取新闻记者证人员名单公示

根据国家新闻出版署关于《新闻记者证管理办法》,《中国电子报》已对申领新闻记者证的资格进行严格审核,现将名单进行公示,接受社会各界监督,举报电话为:010-88558795。拟领取新闻记者证人员名单如下:张琪玮。

中国电子报  
2024年7月24日

# AMD全力押注AI

本报记者 姬晓婷

半导体商圈,像是一个巨大的赌局。一次选择的失误,就可能意味着失去“上桌”的权利。而一次成功的抉择,却没有很长的“保质期”。带领AMD从至暗时刻走出的公司董事长兼CEO苏姿丰,怕是深谙这句话背后的道理。经历了三起三落的苏姿丰,在AI时代,再次选择了“All in(全力押注)”。

## 一年投资十几家AI公司

美国加利福尼亚时间7月10日,AMD官网发布了这样一条消息:以全现金交易收购欧洲最大的私人人工智能实验室Silo AI,价值约为6.65亿美元。

这条消息经由苏姿丰个人社交媒体X转发,引起了业界的广泛关注。一众媒体开始挖掘这家公司的创始人以及被冠以“豪华”名号的团队。然而,很少有人注意到,在AMD发布的这则声明中还有这样一句话:在过去的12个月里,AMD向十几家AI公司的投资金额超过了1.25亿美元,还收购了Mipsology和Nod.ai,以扩展AMD AI生态系统、支持合作伙伴

## AI全家桶

6月3日,苏姿丰带着标志性的笑容和几乎覆盖所有产品线的更新,来到2024台北电脑展,进行了一场一个多小时的演讲。

在这场演讲中,“AI”是她说的最多的一个词。

从产品类型来看,AMD的业务范围涵盖CPU、GPU、FPGA三大类产品线。

从应用场景来看,AMD将其业务划分为云、高性能计算、企业、嵌入式和PC五大类型。

而“AI”这一关键词,贯穿三大产品线、五大应用场景业务。用苏姿丰本人的话来说,AMD正在“为端到端AI基础设施提供推动力”。从硬件上来看,AMD的全线产品更新,都是为人工智能训练和推理提供更高性能的计算引擎,这包括CPU、GPU、NPU。从软件上来看,AMD正在试图搭建开放的、经过验证的且对开发人员友好的AI框架和模型,构建与AMD硬件完全适配的生态系统。

公布竞品比分是AMD最擅长的经营策略。AMD也曾凭此方法实

## 开放、开源、定制化

现了对竞品市场份额的争夺。2011年,AMD推出企业级芯片霄龙,对标当时市场上认可度最高的Intel至强处理器,并在官网上直接提供霄龙与至强的TCO对比工具,凸显霄龙耗电量的优势,一举拉高了霄龙在服务器CPU市场的采购比例。

在台北电脑展上,苏姿丰再次采用这一战略,全方位“碰瓷”竞争对手且对比项集中于AI模型运算适配度。

当介绍第三代Ryzen时,苏姿丰着重强调了其NPU的AI处理能力,称在处理8位浮点数据类型时,第三代Ryzen AI性能优于高通骁龙X Elite、英特尔Lunar Lake、Apple M4等竞争对手。

当介绍Ryzen AI300时,苏姿丰强调其与所有x86和Arm CPU相比的单线程相应能力、多任务处理能力更优。

转向服务器领域,苏姿丰又将老对手Intel拉上了PK台,苏姿丰声称其代号为“Turin”的第五代128核EPYC产品与Intel Xeon 64核8592

并提升AMD计算平台的领导地位。

关于收购AI团队对AMD自身业务的影响,Counterpoint研究副总监Mohit Agrawal在接受《中国电子报》记者采访时给出了这样的回复:通过收购Silo AI,AMD得以增强软件功能。借助Silo AI的SiloOS和MLOps(机器学习运维)功能,AMD现在可以为客户提供更全面的端到端AI解决方案,包括允许定制AI解决方案的高级工具和模块化软件组件,以及用于大规模部署、优化和操作AI模型的功能。收购Silo AI也使AMD服务层能力得以增长。

此外,Mohit Agrawal还回应称:

Nod.ai增强了AMD的AI软件生态系统,为开发人员提供了必要的工具、库和模型。Mipsology为AMD硬件带来了量身定制的复杂AI推理和优化解决方案,支持公司的统一AI堆栈,用于跨边缘和云环境的训练和推理。

简单总结一下,收购一众AI团队,使AMD服务AI客户的软件能力增强了,这将极大地提升其AI解决方案供应能力。

当前,在AI芯片的竞争格局中,软件对于硬件性能的发挥尤其重要。在接受《中国电子报》记者采访时,半导体业内人士李国强打了个比方:“就

像一辆车,高质量的马达加上卓越的调校才能跑得更快更顺滑。”对于AI芯片公司来说,好的软件,就像是帮客户把一辆跑车全面融合协调起来的强劲引擎。软件和硬件适配得好,AI芯片这个算力巨兽,才能跑得更快。

而AI芯片行业领军企业英伟达,有超过70%的研发人员是软件工程师,他们所做的工作,有一个重要的目标:帮助客户把英伟达的硬件性能发挥得更好。相较于英伟达,软件工具和服务能力是AMD一大短板。

无疑,对AI公司的收购将帮助AMD缩小其与英伟达之间软件的能力差距。

“AI”这一关键词,贯穿三大产品线、五大应用场景业务,可以说AMD正在“为端到端AI基础设施提供推动力”。

相比,在运行计算密集型科学软件NAMD、虚拟运行Llama-2 7B大模型以应对常见企业场景时具有更高的性能表现力。

不仅如此,苏姿丰还展示了将于2025年推出的Instinct MI350服务器端产品与英伟达B200的性能对比,宣称MI350支持内存为B200的1.5倍,人工计算性能为B200的1.2倍。

在软件方面,苏姿丰展示了AMD开放式软件栈ROCm对AI硬件和操作系统的支持力度,并把主要竞争对手英伟达的H100与自家Instinct MI300X拉上了PK台,对比了在ROCm助力下,二者对Meta Llama-3 70B大模型、Mistral 7B大模型的推理性能,结果是Instinct MI300X分别以1.3倍于H100和1.2倍于H100的比分胜出。

对于AMD而言,在发布会上公开与竞品的性能对比数据,无疑像田忌赛马,对比项限定的场景必然都是精挑细选的,既能突出自身优势,又能压对手一头。综合来看,AMD林林总总的对比传递出两

收购一众AI团队,使AMD服务AI客户的软件能力增强了,这将极大地提升其AI解决方案供应能力。

“AI”这一关键词,贯穿三大产品线、五大应用场景业务,可以说AMD正在“为端到端AI基础设施提供推动力”。

AI时代,具有大规模运算需求的客户资源有限,入局速度决定着AI芯片企业未来在该领域的话语权。

乎不难看出苏姿丰在AI这波时代红利下的布局战略:

第一步,打造出性能过关的硬件产品,并与业内主流的大模型公司做功能适配。

第二步,聚拢一波使用AMD硬件的AI公司,一边利用这些公司的既有客户拓展市场,一边把这些案例打造成能讲出成功故事的“样板间”。在此过程中培养为客户提供定制化方案的能力。

第三步,争取得到重点区域的稳定客户。例如AMD近期收购的Silo AI是一家欧洲公司,AMD便有机会借由其在欧洲的影响力实现一定区域内的市场拓展。

第四步,逐渐将产品影响力拓展到更多地区。英伟达固然是一个强大的竞争对手。但对于客户来说,也不见得总要拼性能最顶的产品,毕竟,除了性能,价格也是非常关键的参考要素。

综合AMD近期的系列动作,似